

日月光一〇三年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 103 年 4 月 25 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇三年度第一季獲利報告，本公司一〇三年第一季之合併營業收入較一〇二年第四季下滑 15%，較一〇二年同期成長 14%，為新台幣 54,700 百萬元。茲將日月光一〇三年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	103 年度 第一季	102 年度 第四季	102 年度 第一季
營業收入	54,700	64,164	48,190
營業毛利	10,349	12,510	8,281
營業淨利(淨損)	5,070	6,940	3,603
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,284	5,792	3,159
所得稅利益(費用)	(727)	(450)	(803)
非控制權益純損(益)	(119)	(134)	(125)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	3,438	5,208	2,231
稀釋每股盈餘(元)	0.44	0.66	0.29

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	103 年度 第一季	102 年度 第四季	102 年度 第一季
營業收入	34,351	37,900	31,317
營業毛利	8,243	10,448	6,224
營業淨利(淨損)	4,210	6,150	2,669
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,038	5,655	2,776
所得稅利益(費用)	(570)	(406)	(506)
非控制權益純損(益)	(30)	(41)	(39)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	3,438	5,208	2,231
稀釋每股盈餘(元)	0.44	0.66	0.29

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	52
個人電腦	12
汽車及消費性電子產品	36
其他	0
前十大客戶佔營收比重	47

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	60
歐洲	11
台灣	17
日本	7
亞洲其他地區	5

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced Packaging	27
IC Wirebonding	64
Discrete and Others	9
封裝資本支出金額	65 百萬美元
打線機台數	15,375 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	79
晶圓測試	19
前段測試	2
測試資本支出金額	27 百萬美元
測試機台數	3,155 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	48
電腦產品	22
消費產品	10
工業產品	12
汽車電子產品	7
其他	1
前十大客戶佔營收比重	86
EMS 資本支出金額	16 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2014 年第二季的業績展望如下：

- 半導體封裝測試材料營收將接近去年第四季的水準，電子製造代工服務營收將持平至微幅下滑；
- 合併營業毛利率預計將超越去年第四季的水準，且超過 20%；
- 全年在設備方面的資本支出將會增加約美金 2 億至 2.5 億元，並根據市場狀況調整。